WEEKLY REVIEW / 美股市场周评

防御格局延续
硬件修复待确认

金融压力进入谨慎区间，行业反弹仍缺广泛确认

综合风险 · 暂定	AI 硬件 · 弱	SMH 近 20 个交易日
67.7	15.2	−9.8%

Taiyang Feng (Sunny)

2026-11-15

权益截至 2026-11-13 · ACM 截至 2026-11-12

What remains persists.

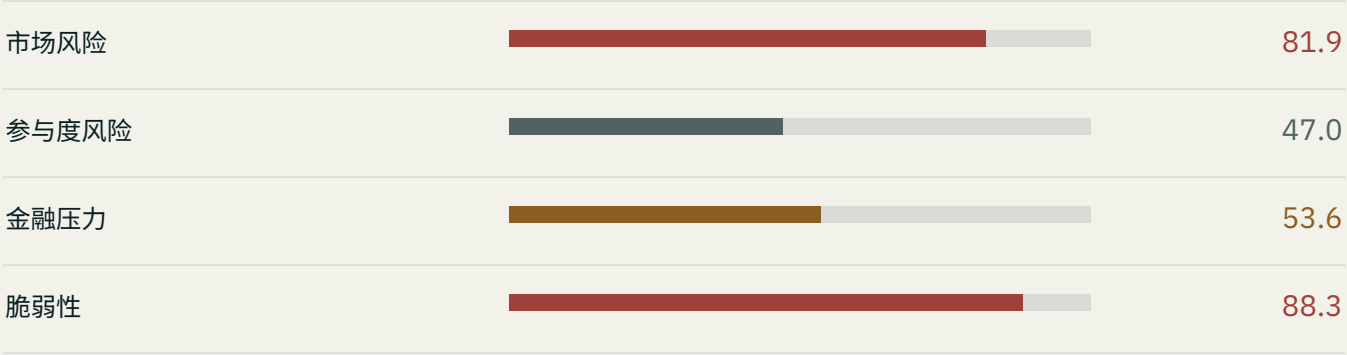
01 / MARKET REGIME

综合状态防御，内部支撑仍弱

11 月 13 日，美股综合风险评分为 67.7，处于防御区间。市场风险为 81.9，脆弱性为 88.3，两项均处压力区。参与度风险为 47.0，处于中性区间。金融压力为 53.6，进入谨慎区间。

市场广度不足、因子拥挤和趋势脆弱性继续约束风险偏好。当日约 44.8% 的股票位于 200 日均线上方，参与面仍未过半。Livermore S2 为 82.3，处于 Active 状态，提示上涨趋势衰竭风险。市场内部仍缺少足够支撑。

综合模型采用的金融条件数据截至 11 月 6 日，NFCI 为 −0.462，ANFCI 为 −0.477，差值为 +0.015。两项指数均低于零。金融压力评分进入谨慎区间，需要继续观察信用与融资条件，现有证据尚不足以确认系统性流动性危机。



02 / SEMICONDUCTORS / AI HARDWARE

硬件有所修复，行业确认仍不足

截至 11 月 13 日，半导体与 AI 硬件综合分回升至 15.2，页面整数显示为 15，整体仍处弱势。SMH 近 5 个交易日上涨 4.9%，近 20 个交易日仍下跌 9.8%，同期落后 QQQ 约 5.6 个百分点。短期反弹尚未扭转相对弱势。

28 只监测股票中，25% 站上 20 日均线，约 21% 站上 50 日均线。需求动量仅为 8，供应链确认为 16，领导广度为 22，相对风险偏好为 34。分化脆弱性仍高达 80，行业修复缺少广泛确认。

近 20 个交易日，NXPI、MPWR 和 ANET 分别上涨 15.6%、14.8% 和 11.5%，INTC、MRVL 和 NVDA 分别下跌 33.6%、31.2% 和 23.9%。晶圆代工与设备、存储两组均无成员站上 20 日均线，修复仍不均衡。

硬件综合分	15.2 / Weak
SMH 近 20 个交易日	−9.8%
站上 20 日 / 50 日均线	25% / 21%
需求动量 / 供应链确认	8 / 16

03 / TREASURY YIELDS

期限溢价压缩，抵消利率预期上行

截至 11 月 12 日，纽约联储发布的 ACM 模型 10 年期美债拟合收益率为 5.066%，预期短端利率分项为 4.390%，期限溢价为 0.675%。各项水平按显示精度取整。

从 10 月 13 日到 11 月 12 日的 21 个观测日间隔内，拟合收益率下降 12.65 个基点。预期短端利率分项贡献 +5.22 个基点，期限溢价贡献 −17.87 个基点。两项方向相反，长端净回落来自期限溢价压缩幅度超过利率预期的上行。

这一变化缓和了部分长端估值压力。利率预期分项仍在上行，权益配置还需结合市场广度和行业动量的修复程度。

10 年期 ACM • 2026-10-13 至 2026-11-12

预期短端利率分项	+5.22 bp
期限溢价分项	−17.87 bp
拟合收益率净变化	−12.65 bp

04 / POSITIONING & DATA

继续防御，等待广度与动量改善

当前继续维持防御配置，控制高拥挤资产敞口。半导体反弹已有局部改善，需求动量、供应链确认和领导广度仍弱，承担更多风险所需的证据尚不充分。

提高仓位前，观察市场广度能否持续扩大，以及半导体相对 QQQ 的弱势能否缓解，并由需求与供应链指标共同确认。金融压力进入谨慎区间后，也需关注信用与融资条件是否进一步收紧。

本周继续调整 HML 数据覆盖门槛及估算口径，UMD 仍采用代理输入。67.7 为暂定估算，跨模型版本不作直接比较。权益与硬件数据截至 11 月 13 日，金融条件输入截至 11 月 6 日，ACM 截至 11 月 12 日；各模块采用各自最近可用数据。

配置立场

防御

观察截至 2026-11-13

来源与披露

1. 本期冻结观察数据
2. 余势美股市场看板
3. 芝加哥联储金融条件指数
4. 纽约联储 ACM 期限溢价数据

本材料仅用于研究与信息交流，不构成投资建议。